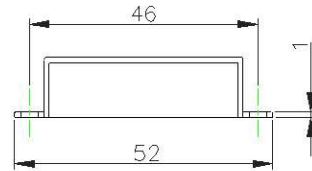
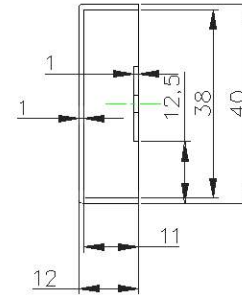
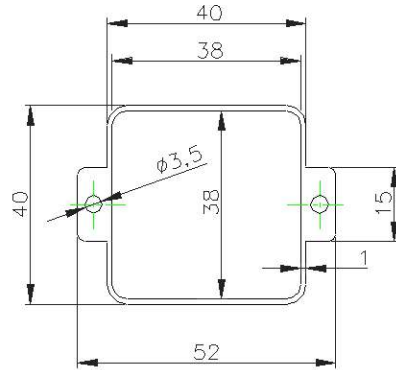


Modul- Gehäuseoberteil



Modul- Gehäuseoberteil schwarz.  
 Modul- Gehäuseoberteil mit offenem Boden.  
 Gehäuse wird nach Einsetzen und Anschliessen  
 der Platine mit Gießharz verschlossen.

[Verwendungsbereich] G059 Modul-Gehäuse mit Befestigungsloschen		[Zul. Abw.]	[Oberfl.]	Maßstab 1:1	[Gewicht]	
				[Werkstoff, Halbzeug] [Rohteil-Nr]	Thermoplast	
			Datum	Name	MODUL-GEHÄUSE	
			Bearb	25.04.05		M.SIMON
			Gepr.			
			Norm			
					G059	
Zust	Änderung	Datum	Name	KEMO-Electronic GmbH		
				Ersatz für:	Ersatz durch:	
					Blatt 1 von 1 Blätter	